

Brewer Science® 半导体设备

适用于科研机构和小量生产单位



Brewer Science 设备可帮助您经济高效地进入一个全新的领域进行产品开发及生产。我们的设备已被广泛的应用于半导体制造，MEMS生产，薄膜工艺，传感器，以及先进封装技术之中。紧凑的尺寸，新颖的设计，以及多年生产高性能设备的经验，Brewer Science®设备是科研以及小规模生产的理想选择。

主要特点：

- ▶ 精确控制
- ▶ 使用简单
- ▶ 灵活
- ▶ 可编写程序
- ▶ 尺寸紧凑
- ▶ 重复性高



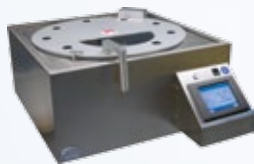
Cee® X系列精密设备拥有强大的接口功能，优异的化学兼容性，以及方便紧凑的空间设计。秉承了传统Cee®多年一贯的优异品质，新一代的X系列进一步配备了独立的PC控制系统，7英寸

全彩色触摸屏，耐各种化学品腐蚀的特氟隆®旋转碗，可编程控制的热板顶针系统，优异的温度均匀性（晶圆表面温度差异在±0.3%之内），以及无限的工艺程序存储空间。

匀胶设备



Cee® 200X



Cee® 300X

一体化设备



Cee® 200CBX



Cee® 200DBX

烤胶设备

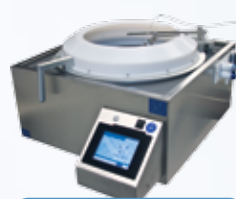


Cee® 1300X

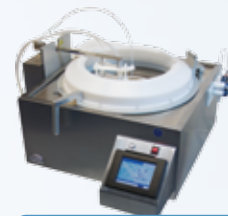
显影设备



Cee® 200XD



Cee® 300XD



Cee® 300MXD

匀胶设备

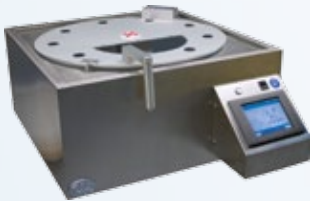
Cee® 200X 精密匀胶机



Brewer Science® Cee® 200X精密匀胶机是科研机构，大学，MEMS 以及实验室的最佳选择。该设备实现全部程序化控制，图形化用户界面简单易于操作。优异的精确度和高重复性设计用以消除来自于光刻胶与沉积薄膜的工艺差别。200X精致小巧，使用方便，化学兼容性强，其突出的耐用性可以为您提供多年高品质的服务，大大降低使用和维护的成本。Cee®200X精密匀胶机可处理最大尺寸为200mm的圆片或者7英寸方形基片。



Cee® 300X 大型匀胶机



Brewer Science® Cee® 300X大型匀胶机专为较大尺寸和较重的基片所设计。Cee® 300X 配备了极其精确的旋转控制系统和大马力驱动系统，同时配备了以PC Windows®为基础的控制系統，为您提供了最友好的客户应用界面。Cee®300X大型匀胶机可处理从3英寸到450mm晶圆以及大尺寸LCD 基片（最大可为14英寸x 14英寸）。



显影设备

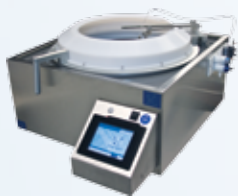
Cee® 200XD 喷涂显影设备



Brewer Science® Cee® 200XD是按照track品质要求设计的喷涂显影设备，设计高效而紧凑，配置有7英寸全彩色触摸屏，极强的化学兼容性，可灵活使用于各种工艺。标准配置配有两个V-型喷头来喷涂显影液和去离子水。配合敞开放式 UHMW 盖子，喷头既可安装在晶圆平面之外采用自外向内的喷涂方式(浸没喷涂)，也可以直接安装在基片上方来连续（直接）喷涂。



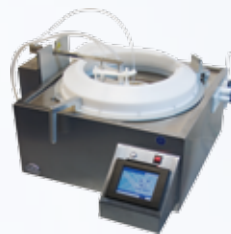
Cee® 300XD 大型显影机



Brewer Science® Cee® 300XD支持喷淋式，浸没式和水柱式显影方式，可处理最大尺寸为300mm的圆片或者14英寸方形基片square。



Cee® 300MXD 兆频超声波显影 / 清洁设备



Cee® 300MXD兆频超声波显影 / 清洁设备利用独特的兆频超声波清洗技术（ProSys MegPie），在旋转的基片上加載均匀的声波能量，配合大马力驱动提高旋转加速度，有效提高显影和清洗效率。



烤胶设备

Cee® 1300X 精密热板



Brewer Science® Cee® 1300X精密热板具有高超的温控准确性和重复性，从而有效地消除了设备引起的工艺差异。简单易用的全彩色的触摸界面以及基于Windows®的PC控制系统，可以任意编辑设定存储程序，随时监控工艺参数，可处理最大尺寸200mm的圆片或8英寸方片。紧凑的尺寸，新颖的设计，以及多年来展现出稳定精准的烘烤性能，Cee®1300X 成为小规模生产和各类科研中心的最佳工艺设备选择



Cee® 10 大型热板



Brewer Science Cee® 10大型热板是为小规模生产和各类科研机构加热大尺寸基片而设计，可容纳最大300mm晶圆或者14英寸方形基片。

Cee® 11 大型热板



Brewer Science® Cee® 11大型热板是专为超大尺寸基片设计,可容纳最大450mm圆形或者20英寸方形基片。同时Cee®11沿用了紧凑的空间设计,可方便的安装在您现有的洁净室通风厨或者实验室桌面上。

一体化设备

Cee® 200CBX 精密匀胶 / 热板组合



Brewer Science® Cee® 200CBX精密匀胶 / 热板组合由一个track品质的高精度匀胶模块和一个高均匀性的热板模块组成。基于PC Windows® 的图形用户界面简单易用，可以方便地输入，观察，和储存用户程序。Cee®200CBX因其精简新颖的设计，以及多年来体现的高度可靠性，精确性以及工艺的稳定性，受到众多小规模生产和各类实验室的青睐。



Cee® 200DBX 精密显影 / 热板组合

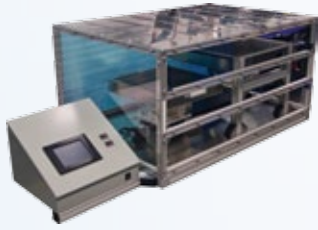


Brewer Science® Cee® 200DBX精密显影 / 热板组合由一个高精度的track品质的显影模块和一个高均匀性的热板模块组成，用于曝光后的显影和后烘烤，为世界各地的用户在先进光刻，光学研究，MEMS和纳米技术等最尖端领域的研究提供可靠而重复性高的试验结果。



解键合设备

Cee® 1300DB 热解键合设备



Brewer Science® Cee® 1300DB 半自动解键合设备利用加热滑移原理使各类键合的超薄晶圆分离。该设备可帮助研发工程师在保密的研发环境中实现超薄晶圆工艺的关键步骤解键合，完成完整的工艺开发。该设备亦可用于小量样品生产，大大缩短产品开发周期，加速新产品上市，以提高竞争力。

ZoneBOND™ 常温解键合设备



Brewer Science® ZoneBOND™ 常温分离设备用于分离采用ZoneBOND™技术键合的超薄晶圆。ZoneBOND™系统使用特殊的耐高温材料扩大了薄晶圆的工艺温度应用范围，同时又可在室温环境中进行低应力分离

内嵌式设计

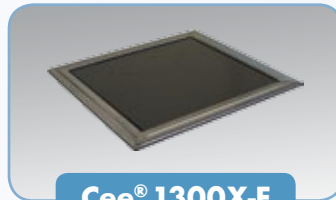
Cee® 内嵌式 X-系列设备



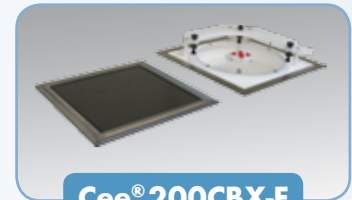
Cee® X-series 系列产品可灵活改装为内嵌式设计，以有效节省空间。有以下型号可供选择：



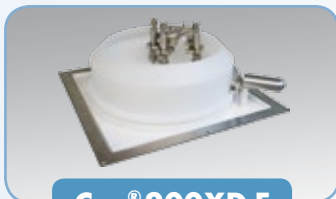
Cee® 200X-F



Cee® 1300X-F



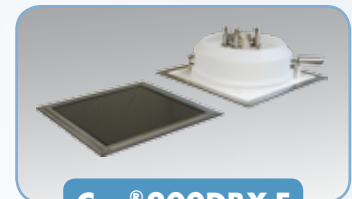
Cee® 200CBX-F



Cee® 200XD-F



Windows®-based PC controller mounts separately and attaches via umbilical



Cee® 200DBX-F

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

All statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests we believe to be accurate, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed and the following is made in lieu of warranty expressed or implied. Neither the seller nor manufacturer shall be liable for any injury, loss or damage, direct or consequential, arising from the use or inability to use the product. Before using, user shall determine the suitability of the product for his intended use, and user assumes all risk and liability whatsoever in connection therewith. No statement or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in an agreement signed by officers of the seller and manufacturer.